

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于参加 2023 年度半导体材料集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议线上交流时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：线上文字互动
- 线上文字互动平台：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可在 2024 年 5 月 16 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况以及发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板半导体材料集体业绩说明会，此次活动将以线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上文字互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00-17:00

(二) 会议召开方式：线上文字互动

(三) 线上文字互动平台：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(四) 投资者可在2024年5月16日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长：蔡国智

董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理：朱才伟

独立董事：安广实

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、联系人及咨询办法

联系人：曹宗野

电话：0551-62637000 转 612688

邮箱：stock@nexchip.com.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年5月10日